**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

附件3

**蒐集個人資料告知事項**

受經濟部產業發展署委託之專案計畫承辦單位-財團法人精密機械研究發展中心(以下簡稱本中心)為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本中心前，依法告知下列事項：

1. 本中心受經濟部產業發展署委託辦理「疫後特別預算-金屬產業智慧機上盒輔導計畫」，因工業行政、中小企業及其他產業之輔導等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、國民身分證統一編號、性別、職業、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
2. 本中心將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本中心個資作業規定及隱私權保護政策，蒐集、處理及利用您的個人資料。
3. 本中心將於蒐集目的之存續期間合理利用您的個人資料。
4. 除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
5. 您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本中心(聯絡電話：04-23599009\*299、電子郵件：SMB-GMP@mail.pmc.org.tw)行使之下列權利：
6. 查詢或請求閱覽。
7. 請求製給複製本。
8. 請求補充或更正。
9. 請求停止蒐集、處理及利用。
10. 請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本中心不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第14條規定，本中心得酌收行政作業費用。

1. 若您未提供正確之個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關業務。
2. 本中心因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本中心將會善盡監督之責。
3. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本中心留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供**

1. 本人已充分知悉上述告知事項。
2. 本人同意受經濟部產業發展署委託之專案計畫承辦單位-財團法人精密機械研究發展中心蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人：

中華民國 113 年 月 日